

LICENCIA Z MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKEJ FAKULTY

Opisom technológie pod názvom Mäkká aktívna spájka na ultrazvukové spájkovanie nekovových a kovových alebo dvoch nekovových materiálov pri vyšších aplikačných teplotách, pôvodcov technológie zamestnancov Materiálovotechnologickej fakulty STU, a to prof. Ing. Romana Koleňáka, PhD. a Ing. Igora Kostolného, PhD., sa zaoberá článok ÚSPECHY KOMERCIALIZÁCIE NA STU V BRATISLAVE, uverejnený v bulletine TRANSFER TECHNOLOGIÍ 1/2023.

Hlavnou konkurenčnou výhodou technológie bola skutočnosť, že nová zliatina mala vynikajúcu zmáčavosť na širokej škále keramických a ťažko spájkovateľných kovových materiálov a zároveň dosahovala podobnú pevnosť spoja ako konkurenčná S-Bond spájka Sn-Ag-Ti, pričom vzhľadom na to, že neobsahovala striebro, bola lacnejšia. Z uvedeného dôvodu sa pristúpilo k podaniu medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) na vynález. Finančné prostriedky na PCT prihlášku boli použité z patentového fondu CVTI SR.

Zdroj: https://ttb.sk/wp-content/uploads/2023/04/WEB_tt_b_1_2023-1.pdf